

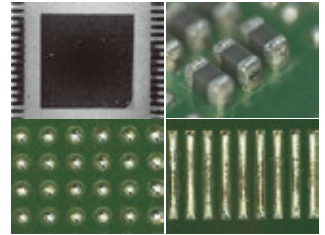
### TRINITY SMICで、低飛散、ボイド&残渣フリー実装を実現

Low-Splash, Non-Residue & Void-free Solutions from TRINITY SMIC

#### 特長

- 優れたフラックス材料開発力が、残渣フリーフラックス**NRBシリーズ**を開発
- はんだ付けを熟知しているメーカーの、**SVR-625GTC**でボイドフリー
- 材料と装置に、ノウハウを加えて低飛散、残渣&ボイドフリー実装を実現

低飛散、ボイド&残渣フリーを実現



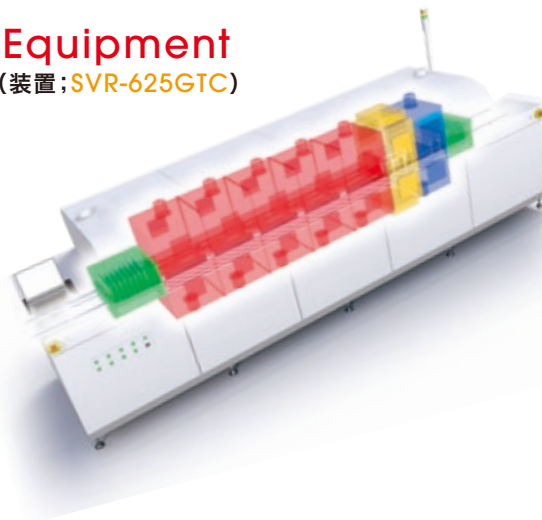
#### Revolutionary Products

### TRINITY SMICで、低飛散、ボイド&残渣フリー実装を実現

#### Material (材料;NRB60)



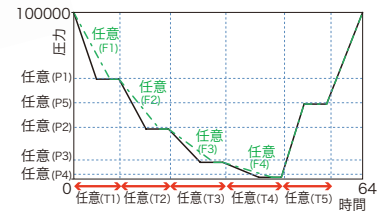
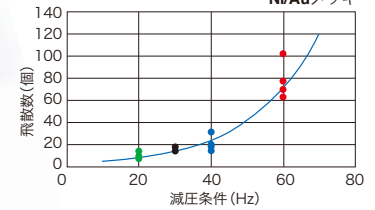
#### Equipment (装置;SVR-625GTC)



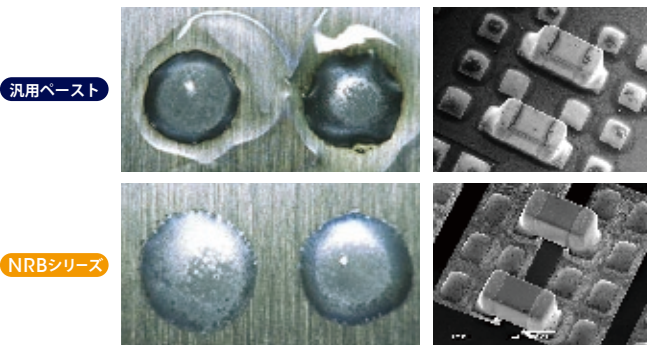
#### Process (工法;Know-How)

温度と減圧制御が可能な真空炉で飛散を抑制

はんだペースト：SAC305ロジン系  
Ni/Auメッキ



- NRBシリーズフラックスの開発が、残渣フリーを実現



- NRB60とSVR-625GTCでボイドフリーを実現

材料と装置の組み合わせが重要

